

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 12 月 4 日(04.12.2014)



(10) 国際公開番号
WO 2014/192745 A1

- (51) 国際特許分類:
C09J 133/00 (2006.01) *C09J 163/10* (2006.01)
C09J 5/00 (2006.01) *H01L 21/301* (2006.01)
C09J 7/00 (2006.01) *H01L 21/52* (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01) *H01L 25/065* (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01) *H01L 25/07* (2006.01)
C09J 163/00 (2006.01) *H01L 25/18* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/063979
- (22) 国際出願日: 2014 年 5 月 27 日(27.05.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-111974 2013 年 5 月 28 日(28.05.2013) JP
特願 2013-126935 2013 年 6 月 17 日(17.06.2013) JP
- (71) 出願人: リンテック株式会社(LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 - 2 3 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 土山 さやか(TSUCHIYAMA, Sayaka); 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 - 2 3 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 佐伯 尚哉(SAIKI, Naoya); 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 - 2 3 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 吾妻 祐一郎(AZUMA, Yuichiro); 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 - 2 3 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 鈴木 英明(SUZUKI, Hideaki); 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 - 2 3 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 前田・鈴木国際特許業務法人(MAEDA & SUZUKI); 〒1010051 東京都千代田区神田神保町一丁目 1 番地 1 7 東京堂神保町第 3 ビル 2 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロピア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: ADHESIVE AGENT COMPOSITION, ADHESIVE SHEET, AND METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 接着剤組成物、接着シートおよび半導体装置の製造方法

(57) Abstract: [Problem] To provide: an adhesive agent composition, whereby it becomes possible to compound a filler into an adhesive agent layer uniformly, it also becomes possible to perform wire bonding stably before curing and to exhibit excellent adhesion strength after curing even when a process for curing all of adhesive agent layers simultaneously is employed in the production of a multilayer package, and it also becomes possible to achieve high packaging reliability particularly in a semiconductor device; an adhesive sheet having an adhesive agent layer formed from the adhesive agent composition; and a method for manufacturing a semiconductor device using the adhesive sheet. [Solution] The adhesive agent composition according to the present invention comprises (A) an acrylic polymer, (B) a thermally curable resin having a reactive double bond group and (C) a filler having a reactive double bond group on the surface thereof, wherein the acrylic polymer (A) has a weight average molecular weight of 500,000 or more, the thermally curable resin (B) comprises an epoxy resin and a thermal curing agent, and the epoxy resin and/or the thermal curing agent has a reactive double bond group.

(57) 要約: 【課題】接着剤層中にフィラーを均一に混合でき、多段パッケージの製造に際して接着剤層を一括硬化するプロセスを採用した場合であっても、硬化前にはワイヤボンディングを安定して行え、硬化後には優れた接着強度を示し、特に半導体装置において高いパッケージ信頼性を達成できる接着剤組成物および該接着剤組成物からなる接着剤層を有する接着シートならびに該接着シートを用いた半導体装置の製造方法を提供すること。【解決手段】本発明の接着剤組成物は、アクリル重合体 (A)、反応性二重結合基を有する熱硬化性樹脂 (B) および反応性二重結合基を表面に有するフィラー (C) を含み、当該アクリル重合体 (A) の重量平均分子量が 50 万以上であり、当該熱硬化性樹脂 (B) がエポキシ樹脂および熱硬化剤からなり、当該エポキシ樹脂および当該熱硬化剤の何れか一方または両方が反応性二重結合基を有する。

WO 2014/192745 A1